

Embedded Module mit i.MX8M Mini

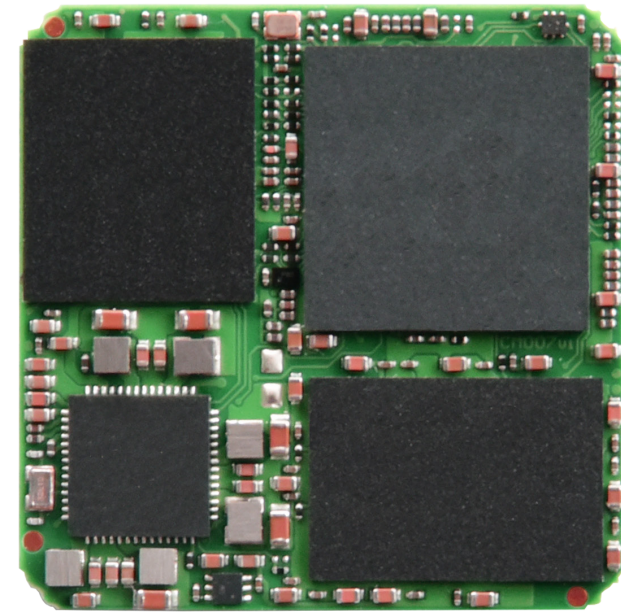
Open Standard Module™ - iesy i.MX8M Mini OSM-SF

Technische Daten

- ▶ Prozessor: i.MX8M Mini Cortex-A53 Quad Core + Cortex-M4 MCU
- ▶ Taktrate: 1,6 GHz (A53) + 400 MHz (M4)
- ▶ Arbeitsspeicher: 1 GByte LPDDR4
- ▶ Flash Speicher: 16 GByte e-MMC 5.1
- ▶ Abmessung: 30 mm x 30 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-S
Land Grid Array (LGA) mit 332 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: Single Supply 5 VDC
- ▶ Leistungsaufnahme: 1,3 W (typ.) / 3,4 W (max.)
- ▶ Temperaturbereich:
 - > Im Betrieb: -40 °C bis +85 °C
 - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C

Funktionen & Schnittstellen

- ▶ 1x LAN 10/100/1000 (RMII)
- ▶ 1x PCIe x1 (inkl. I2C/SMBUS)
- ▶ 1x MIPI DSI (4 Lanes)
- ▶ 1x MIPI CSI (4 Lanes, inkl. I2C)
- ▶ 1x QSPI, 1x SPI, 3x UART, 1x Debug-UART
- ▶ 2x USB 2.0 (Client/Host/OTG)
- ▶ 1x SD-Card, 1x SDIO/MMC (8 Bit)
- ▶ 2x I2C, 1x I2S (2x TX/RX)
- ▶ 24x GPIO, 3x PWM
- ▶ 1x JTAG



Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.